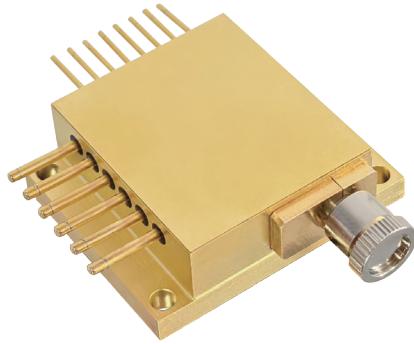


R3M高功率 半导体激光模组



R3M是杏林睿光半导体AW系列多功能激光模组，多波长输出，可集成3种不同波长的主激光。光纤插拔式设计，配置光纤开关、PD光电探测器、RT热敏电阻等功能。

主要功能特点

- ◆ 光斑均匀
- ◆ 功率稳定
- ◆ 散热好
- ◆ 可靠性高
- ◆ 可选不同波长组合输出

应用

- 光谱检测
- 生物医疗
- 材料分析
- 显示照明
- 激光制造

技术参数（25°C）

封装形式		R3M					
		三波长			三波长		
中心波长 (nm)		650	808	9XX / 1064	650	980	1470
光学	连续输出功率 P_{op} (W)	0.5	12	15 / 10	0.5	15	4
	波长公差 (nm)	± 10					
	光谱宽度 $\Delta\lambda$ (nm)	<6					
	波长随温度特性 $\Delta\lambda/\Delta T$ (nm/°C)	0.3					
电学	阈值电流 I_{th} (A)	0.5	1.8	1 / 1.2	0.5	1	1.4
	工作电流 I_{op} (A)	1.2	16	18 / 13	1.2	18	14
	工作电压 V_{op} (V)	2.3	2	1.8 / 1.8	2.3	1.8	1.5
	微分效率 η_{es} (W/A)	0.7	0.9	0.9 / 0.8	0.7	0.9	0.3
光纤	PD电流 I_{pd} (μA)	<8000					
	热敏电阻参数 R_t (kΩ/β (25°C))	10±1%/3930					
	光纤芯径 D_{core} (μm)	400					
	光纤包层直径 D_{clad} (μm)	440					
	光纤涂覆层直径 D_{buffer} (μm)	720					
数值孔径 NA		0.22					
连接器		SMA905					

注：1. 以上表格内所有数据均为室温25°C环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。

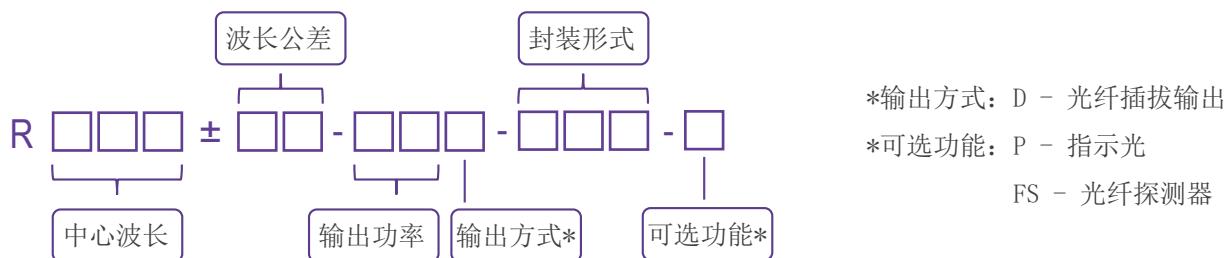
其他参数

参数	工作温度 (°C)	工作相对湿度 (%)	存储温度 (°C)	存储相对湿度 (%)	引脚焊接温度 (max/°C)
最小	10	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

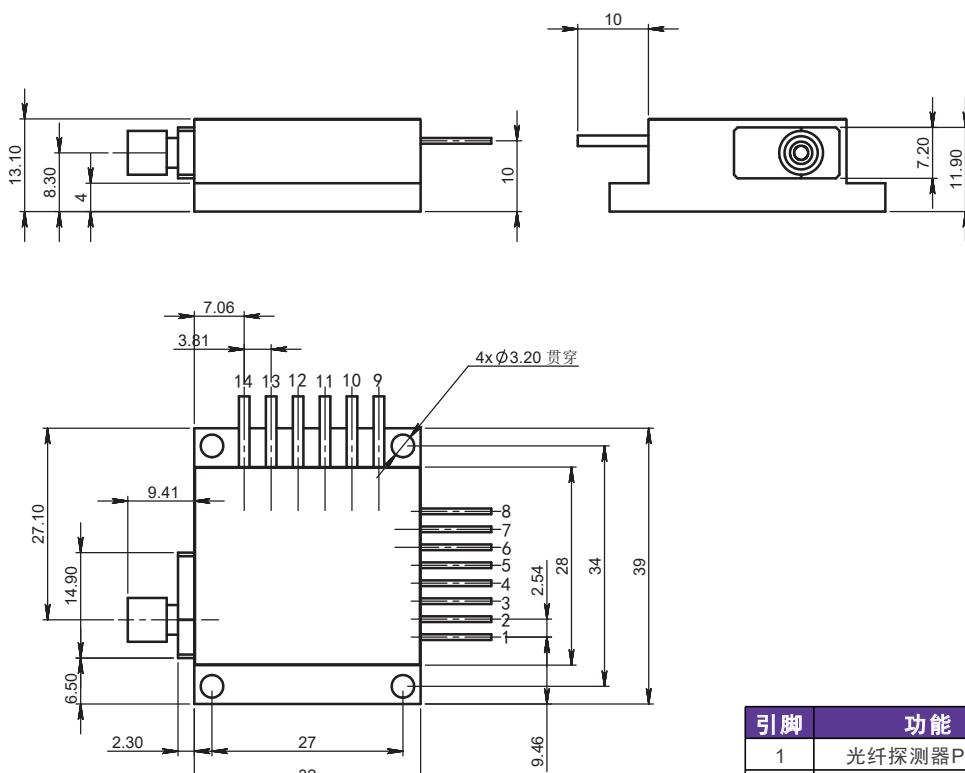
产品型号一览表

封装形式	波长 (nm)	功率	型号
R3M	650/808/9XX	0.5/12/15	R650/808/9XX±10-0.5/12/15WD-R3M-PFS
	650/808/1064	0.5/12/10	R650/808/1064±10-0.5/12/10WD-R3M-PFS
	650/980/1470	0.5/15/4	R650/980/1470±10-0.5/15/4WD-R3M-PFS

产品型号命名规则



机械尺寸图 单位: mm



引脚	功能	引脚	功能
1	光纤探测器PD(P)	8	-
2	光纤探测器LED(+) ; 光纤探测器PD(N)	9	LD2(+)
3	光纤探测器LED(-)	10	LD2(-)
4	PD(P)	11	LD1(+)
5	PD(N)	12	LD1(-)
6	热敏电阻	13	红光(+)
7	热敏电阻	14	红光(-)

